

NFC 應用熱度激增 晶片/量測商機湧現

2013/12/6 鄭景尤, 新電子

近距離無線通訊(NFC)市場商機一觸即發。因應物聯網發展風潮，愈來愈多手機、平板、相機及智慧家電產品製造商對 NFC 技術更加重視且開始大量導入，並將於 2014 年推出相關產品，因而帶動 NFC 晶片與量測需求快速爆發。



筑波科技營運長許棟材(圖左)，筑波科技業務副總經理張佳楨(圖右)

筑波科技營運長許棟材表示，NFC 已連續 3 年被全球行動通訊大會(MWC)列為展覽重點，且行動裝置品牌業者如索尼(Sony)、諾基亞(Nokia)、宏達電、小米科技等皆已將 NFC 功能導入最新手機中，做為與物聯網(IoT)商機接軌的重要技術。

事實上，金融業者銀聯、威士(Visa)、萬事達(Mastercard)等亦看好 NFC 技術的發展潛力，正戮力發展以 NFC 做為行動支付基礎的產品，期先行插旗市場，避免行動支付市場發球權遭電信業者利用手機或其他通訊裝置奪走。

筑波科技業務副總經理張佳楨指出，由於 NFC 係無線射頻辨識(RFID)技術的一環，切入門檻不高，且晶片成本低，因而成為各領域業者切入物聯網戰場的重要途徑。

據了解，目前 NFC 晶片商正卯足全力擴大市占，其中恩智浦(NXP)、博通(Broadcom)的產品已分別獲得三星(Samsung)、樂金(LG)青睞並導入今年的旗艦機中，而聯發科、高通(Qualcomm)則已推出與應用處理器(AP)搭配的獨立式 NFC 晶片，以參考設計的方式提高原始設備製造商 (OEM)採用意願。

張佳楨指出，台灣廠商從積體電路(IC)設計、系統廠、原始設計製造商(ODM)等皆對 NFC 躍躍欲試，希望可以一舉跨入價值鏈(Value Chain)中，因此相關量測需求詢問熱度也節節攀升。

以手機應用為例，業者多半將量測重點聚焦於實體層(PHY Layer)，並採用萊特波特(Litepoint)的 IQxel-M 同時針對 NFC、無線區域網路(Wi-Fi)、藍牙(Bluetooth)等多種無線通訊技術進行驗證。

不過，若業者想進一步揮軍行動支付應用市場，則須通過 EMVCo 標準認證。EMVCo 係由 Visa、美國運通(American Express)、萬事達、銀聯等多家信用卡業者針對支付系統(Payment System)所訂定的硬體標準，因此若行動裝置欲提供行動支付功能，EMVCo 認證將是重要關鍵。

許棟材指出，針對此類需求，筑波科技已代理 Micropross 的 NFC 非接觸式測試機台(Contactless Test Station)，該機台同時通過 NFC 論壇(NFC Forum)、EMVCo、國際標準化組織(ISO)等認證，可確保客戶產品符合行動支付安全標準。